

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏先锋精密科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司名称：江苏先锋精密科技股份有限公司
保荐代表人姓名：刘天宇	联系电话：0512-85883377
保荐代表人姓名：金鸣	联系电话：0512-85883377

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”或“公司”）首次公开发行股票保荐人，对先锋精科进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、无法跟随技术升级迭代的风险

公司所处的半导体设备精密零部件行业属于技术密集型行业，随着芯片制程的不断升级，半导体设备及半导体设备零部件厂商必须紧跟晶圆制造等产业链下游厂商的需求不断提高工艺水平以及产品性能，从而对公司的研发能力、工艺水平不断提出更高要求。此外，对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级优化，提升效率及良品率，公司必须及时研发相匹配的精密零部件产品以应对下游厂商不断提升的技术要求。

若公司产品研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

2、技术人员流失与核心技术泄密的风险

随着市场需求的不断增长与行业竞争的日益激烈，半导体设备精密零部件行业对技术人员的需求不断提升，公司需长期维持技术人员充足、队伍稳定以保持市场竞争力。若无法持续为技术人员提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人员流失的风险

同时，随着半导体行业技术壁垒的不断提高，核心技术对于公司保持和提升竞争力至关重要。自成立以来，公司高度重视对核心技术的保护，但仍不排除因技术人员流失、员工工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，进而导致公司竞争力下降。

（二）经营风险

1、市场空间风险

由于半导体设备精密零部件种类繁多复杂，制作工艺差异巨大，因此即使是全球行业领先的头部企业，也只能专注于个别类型生产工艺，行业相对分散。公司自设立时起即从事半导体设备精密零部件的研发、生产和销售，主要产品原材料以铝、不锈钢等金属为主，为金属类精密零部件，暂未涉及石英件、硅/碳化硅件等其他半导体设备精密零部件。

如未来半导体设备金属精密零部件市场空间被其他材质精密零部件替代，则公司市场空间将下降；此外，如未来新业务相关产品毛利率不能尽快改善或新业务产品收入占比提升，也将拉低公司综合毛利率，进而对公司盈利能力产生不利影响。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，客户集中度较高且较为稳定，主要原因为半导体行业技术和资本高度密集，导致下游设备企业、晶圆代工企业呈现数量少、规模大的特征。若公司主要客户生产经营情况恶化、或由于半导体行业景气度下降导致客户资本性支出下降，进而导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产

生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、公司规模扩大带来的管理和内控风险

报告期内，公司资产规模、营收规模不断增长，管理、技术和生产人员数量持续增加，研发、采购、生产、销售等环节的复杂程度与管理难度也不断提升。同时，公司产品具有多品种、小批量、定制化的特点，公司根据产品的上述特点通过多年的经营管理实践形成了一套柔性化加工生产体系，对公司的经营管理能力亦提出了较高的要求。如公司管理能力不能及时匹配公司经营规模增长，将影响公司的生产经营和长远发展。

4、半导体领域产品种类相对集中的风险

公司半导体领域产品主要以各类精密金属零部件为主，相较于同行业可比公司暂不涉及气体管路，模组产品收入规模也较小。虽然公司在中国大陆刻蚀设备和薄膜沉积设备的同类零部件产品的市场占有率与同行业可比公司基本一致，但由于公司产品种类相对集中，因此在整体经营规模、产品种类、应用领域等方面与行业龙头企业仍有一定差距。

（三）财务风险

1、业绩波动的风险

如果未来发生市场竞争加剧、宏观经济景气度下行、国家产业政策变化、公司不能有效拓展国内外新客户、下游客户投资需求发生波动、研发投入未能及时实现产业化及行业复苏不及预期等情形，公司将面临一定的经营压力，未来业绩存在大幅波动甚至出现亏损的风险。

2、存货余额及存货跌价准备上升、存货周转率下降的风险

公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的存货跌价准备。若公司未来无法及时地预计市场需求的变动，或生产管理不当导致产品滞销、原材料积压等情形，则可能对公司营运资金周转造成不利影响，若半导体市场增速进一

步放缓，原材料价格大幅下跌或市场竞争格局出现重大不利变化，则可能导致存货跌价准备迅速上升的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

3、税收优惠及财政补助政策变动的风险

公司系高新技术企业，享受减按 15% 税率缴纳企业所得税的优惠政策。若未来无法持续获得高新技术企业认定，公司将不能继续享受前述税收优惠。

4、应收账款余额增加、经营活动现金流量净额及应收账款周转率波动的风险

公司客户主要为国内半导体设备龙头厂商，商业信用良好，但未来若主要客户因经营情况或商业信用发生重大不利变化，以及公司对信用风险管控不当，则可能导致应收账款不能及时收回，从而影响公司流动资金的周转和经营业绩。此外，公司近年来业务规模不断扩大，对于营运资金的需求持续增加。若未来公司无法通过股权融资、债务融资等方式合理筹措资金及规划资金使用计划，则公司在营运资金周转方面将会存在一定的风险。

5、新增固定资产折旧和摊销影响盈利能力风险

如因市场环境变化或公司经营管理不善等原因导致增加的生产基地建设项目投产后不能如期产生收益或盈利水平不及预期，新增生产成本和费用将提升公司经营风险，对公司经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

1、行业周期性风险

公司所处的半导体设备精密零部件行业是半导体行业上游，半导体行业的整体发展情况会对公司所处行业产生较大影响。在行业处于周期性上行通道时，公司需要保持及提高产能来满足产业链下游客户快速提升的需求。若公司不能及时应对客户需求的快速增长，可能会导致公司失去既有或潜在客户；在行业处于周期性下行通道时，计算机、消费电子等终端消费市场需求下降，半导体设备厂商、晶圆厂面临产能过剩，继而削减资本性支出，对公司产品的需求亦可能下降。虽

然长期看，半导体行业作为电子信息产业的基石，人类社会智能化、数字化的大趋势将继续演进，半导体行业的长期需求将持续向好，但在行业处于周期性下行通道时，因晶圆制造企业、半导体设备企业削减资本性支出，公司新增订单可能出现下滑，进而影响公司的经营业绩。

2、市场竞争加剧导致产品价格和盈利能力下降风险

随着全球半导体行业的快速发展，对于半导体设备零部件的需求不断增加，吸引越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，抢夺市场份额，同时行业内领先的企业通过并购重组进一步整合资源，使得市场竞争更加激烈。随着半导体领域国产替代进程的不断加速，越来越多的国产零部件厂商加入市场竞争。如果公司未来无法通过提升研发实力、产品性能和客户拓展能力有效应对日益激烈的市场竞争，将导致公司产品的市场竞争力及产品价格下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

3、主要原材料价格波动风险

公司半导体设备零部件产品的原材料主要包括铝、不锈钢、镍等金属，原材料价格的波动直接影响公司产品的成本及毛利率水平。公司生产所需的上述大宗金属原材料虽然具有稳定的来源，但价格容易受到宏观环境、经济周期、市场需求、汇率等因素的影响出现较大波动。未来若原材料市场价格持续出现大幅上涨，或公司难以将原材料价格上涨传导至客户端，可能导致公司营业成本上升，对公司业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

1、产业政策变化风险

公司的业务发展情况与半导体行业的发展情况紧密相关。半导体行业的发展及国产化的推进对于国家产业升级具有至关重要的意义，因此受国家政策和财政补贴因素影响较大，若未来国家对于半导体设备以及半导体设备零部件行业不能持续出台相关政策，将可能对公司业绩产生不利影响。

2、半导体地缘摩擦的风险

集成电路行业主要包括装备制造、制造材料、芯片制造三大领域，近年来，随着美国芯片法案等贸易政策不断加码，地缘半导体摩擦持续升温，集成电路行业已逐步成为重点关注领域。如果未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，进一步通过出口限制等贸易政策构建贸易壁垒、加剧地缘贸易摩擦，将会对我国终端芯片制造的投资强度和投资周期产生不利影响，进而传导至国产装备制造领域，公司客户可能面临与上下游合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响、终端订单需求下降等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

三、重大违规事项

无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元、%

主要会计数据	2025 年度	2024 年度	本期比上年同期增减	2023 年度
营业收入	1,237,727,647.77	1,135,774,130.09	8.98	557,716,937.80
利润总额	217,424,823.32	247,826,439.29	-12.27	89,431,155.44
归属于上市公司股东的净利润	188,895,768.90	213,946,186.64	-11.71	80,274,953.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,087,197.25	213,732,721.73	-12.93	79,785,359.90
经营活动产生的现金流量净额	196,938,321.82	104,842,745.83	87.84	136,073,973.23
	2025 年末	2024 年末	本期比上年同期增减	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,643,267,967.68	1,482,457,951.98	10.85	743,593,110.42
总资产	2,178,590,492.18	1,977,534,391.32	10.17	1,070,546,193.46

（二）主要财务指标

主要财务指标	2025 年度	2024 年度	本期比上年同期增减 (%)	2023 年度
基本每股收益 (元 / 股)	0.93	1.38	-32.61	0.53
稀释每股收益 (元 / 股)	0.93	1.38	-32.61	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.92	1.38	-33.33	0.53
加权平均净资产收益率 (%)	12.15	24.97	减少 12.82 个百分点	11.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.97	24.94	减少 12.97 个百分点	11.48
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.77	5.64	增加 0.13 个百分点	6.51

（三）对公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、营业收入的变动原因：受益于半导体设备关键零部件国产化的不断推进，公司依托技术升级与产品创新，半导体领域核心产品销售持续增长。

2、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动的的原因：公司根据市场需求及发展规划，进行了适度的产能扩充，新增产能所需的基础建设和生产能力已逐步启用，产能吸收进入爬坡阶段；报告期内员工人数增长较快，薪酬支出增加；公司先进制程零部件增长迅速，为满足先进制程对产品更严苛的质量要求，公司不断增加投入，导致成本增加。

3、经营活动产生的现金流量净额变动的原因：本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司销售收入增长而且销售回款总体较好，同时公司加强营运资金的管理。

4、归属于公司股东的净资产、总资产的变动原因：净资产增加主要系公司当年净利润增加；总资产增加的主要原因是销售规模扩大导致应收账款和存货增加，同时公司进行了产能扩充，固定资产投资增加。

5、每股收益、加权平均净资产收益变动的原因：主要系公司 2024 年 12 月公司首次公开发行股票，公司股本大幅增加，导致 2025 年的期初净资产金额大幅增加，加之报告期内利润略有下降。

6、研发投入占营业收入比例的变动原因：2025 年公司持续加大在技术研发投入力度，研发费用增长较快。

五、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、技术优势

技术创新为公司核心竞争力，公司致力于不断提升技术水平，优化工艺路线。目前，公司具备完善的工艺配套能力，主要分为精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、定制化工装开发技术和粉末烧结技术。

2、产品优势

公司产品可以分为半导体类和其他类。半导体类主要产品包括腔体、内衬、加热器、匀气盘等直接参与晶圆反应或与晶圆直接接触的关键工艺部件、工艺部件和结构部件；其他类主要是应用于光伏设备、医疗设备的零部件。公司自设立时起即确立了以刻蚀腔体、内衬等核心零部件为核心的产品发展路径，在刻蚀设备、薄膜沉积设备核心零部件领域凭借产品专精的特点居于重要地位。公司凭借十多年产品优势积累，在国产装备的重要细分领域持续扩大市场占有率，在客户建立了良好的口碑，保持了较为明显的竞争优势。

3、客户优势

公司深耕国内半导体设备精密零部件制造领域，经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。公司自设立时起即伴随中微公司、北方华创、拓荆科技等国产半导体设备龙头企业共同成长，深度参与客户多款先进设备的研发、定型和迭代升级。半导体高端装备奉行严格复制信条，即客户要求严格复制已经确立的工艺标

准，基于此，公司与中国本土装备龙头企业的长期稳定合作形成了深厚的信任基础，建立了与客户协同迭代开发的持续反馈机制。经过多年的行业深耕，公司主要客户现已覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技、屹唐股份、中芯国际、华海清科等知名半导体产业链厂商，有较强的客户先发优势。同时，公司较早确立了陪伴国内半导体设备厂商成长的经营理念，在半导体设备自主可控的国产化浪潮中具有先发优势，未来伴随国产半导体设备零部件需求量的提升，公司的业绩成长确定性较强。

4、生产管理优势

公司具有以“团队合作”为核心，以“质量，计划，成本改造”为导向的先进的生产管理体系。公司管理体系的核心理论为：“准时制生产”“生产节拍时间”“连续流动”“控制式计划体系”“约束理论”“有效产出与入库”“成本生产率趋势”“瓶颈（约束）管理”等。在先进的生产管理理论的引导下，公司不断完善生产管理制度，规范生产环节，配合装备开发技术形成具备低成本、高效率、高产出特点的生产模式。

5、发展战略

公司以纵向深耕半导体为核心，坚定服务于国产半导体设备自主可控的国家战略，持续深耕刻蚀及薄膜沉积、开发探索光刻机这三大“卡脖子”设备的关键零部件领域，致力于保障中国半导体供应链安全。通过募投项目扩大产能，匹配行业高速增长需求。同时横向拓展技术外延，依托通用的精密制造技术平台，公司稳健地向光伏设备、医疗装备以及航天航空领域拓展。这既创造了新的利润增长点，也增强了公司抵御单一行业周期波动的能力。

（二）核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过多年自主研发，公司具备了金属零部件精密机械制造技术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、定制化工装开发技术、粉末烧结技术等多项领先技术，能够根据产品的不同使用环境需求搭配出最高效的材料方案和工艺实现路径。公司代表性核心技术情况列举如下：

1、精密机械制造技术

报告期内，公司紧跟先进制程国产化发展方向及客户需求，针对复杂多样的产品特性，形成了应对多种复杂零件的精密制造技术、高平面度和粗糙度控制制造技术、高精度微小孔制造技术等精密机械制造技术，能够满足半导体设备制程不断迭代演进的技术需求，实现对多种类金属复杂腔体、复杂多面体零部件的超精细切削制造和高精度控制。公司的主要工艺优势为以下四点：

(1) 高精度控制：平面度 $\leq 2\mu\text{m}$ ，平行度 $\leq 10\mu\text{m}$ ，位置度 $\leq \pm 25\mu\text{m}$ ，粗糙度 $\text{Ra}0.02\mu\text{m}$ ，密封面满足超高真空要求；

(2) 柔性制造：支持复杂多面体连续加工，装夹次数减少 50%，加工效率提升 20%；

(3) 微孔加工：对匀气盘等先进制程核心部件，可实现千万级微孔孔径标准差可达到 $0.3\mu\text{m}$ ，孔口及内部洁净无毛刺，满足先进制程需求，独创微孔检验与模拟技术，为产品研发提供有力支持；

(4) 大型腔体一站式服务：选用不同设备组合加工大型腔体，在满足图纸尺寸要求的情况下，大幅度降低零件加工成本，使产品更具竞争力。

2、表面处理技术

公司通过综合运用阳极氧化、化学镀镍、先进涂层和高洁净度清洗等多项表面处理工艺，是国内较早得到半导体装备设备特殊湿法处理认证的供应商，为国内外半导体装备客户提供各类超高洁净度、超强耐腐蚀能力、高抗裂性要求的零部件表面处理、清洗及翻新全制程服务。

报告期内，公司的表面技术创新总结为以下三点：

(1) 湿法表面处理领域：在传统铝合金阳极化工艺上发展出能满足不同场景需求的工艺，如耐热性、耐蚀性、绝缘性、硬度；

(2) 超洁净清洗领域：拥有 CLS10 至 CLS10000 等多等级洁净间，并建立了高制程表面处理专线，通过超洁净材料设备、分线运行及严格的清洗、检验设备，确保零部件达到极高的洁净度标准，满足先进制程对颗粒污染的严格控制

(3) 先进涂层领域：使用阳极化+复合喷涂技术（SPS、ALD、CVD 等）的多层保护技术，开发产品用于更高制程，SPS 涂层孔隙率达到国际先进水平，且已通过客户认证；

3、焊接技术

为达到复合结构精密件的导热性、密封性、洁净度等特定性能要求，半导体设备零部件制造商需要充分评估产品材料性能及功能要求，并对焊接材料、焊接工艺、焊接参数等进行研究，以持续满足不断迭代的半导体设备工艺制程的严苛要求。

公司已经具备多种焊接技术能力，是国内较早通过美国焊接学会（AWS）认证的焊接制造商（CWF），其中以“FSW 搅拌摩擦焊接技术”“机器人自动焊接技术”“真空钎焊技术”“真空电子束焊接技术”为代表，上述技术主要应用于加热器、内衬、传输腔、匀气盘、水冷板等半导体设备精密零部件。“FSW 搅拌摩擦焊接技术”通过对摩擦焊的精准控制，极大提高了焊缝质量，使得内衬在高腐蚀环境下的使用寿命提高三倍以上。“机器人自动焊接技术”具备稳定的焊接质量，一致性高，可精确定位控制焊接轨迹，解决传统手工大批量加工受人为因素影响焊熔深不稳定的问题，焊接质量达到国内半导体设备龙头企业标准。“真空钎焊技术”应用在具有复杂构造的晶圆加热器生产中，实现多达 5 层结构的结合面熔合，满足加热器严苛温均性要求下的高效热传导；通过精准控制焊料，可解决薄壁复杂流道结构的焊接，实现流道畅通无堵塞。

4、高端器件设计及开发技术

从全球范围看，半导体设备使用的高端器件市场主要为国外厂商所垄断，其中加热器是半导体设备零部件中技术难度较高、工艺制造较为复杂且具备完整功

能的高端器件之一。经过多年自主研发，公司是国内少数已实现量产金属晶圆加热器的供应商，并成为国内龙头半导体装备企业的战略合作伙伴。

基于晶圆先进制程中对加热器多样性、高功效、高温均性、高洁净等的严苛要求，公司需要进行针对性结构设计，将经过特殊设计的发热元件与载台匹配组合，通过热场设计、仿真模拟和功能实验等技术手段，使发热元件性能和晶圆接触结构精确匹配，实现半导体制程中的精准温控，满足半导体产品工艺效益和持续可靠性要求。公司投入全新实验室，优化更新现有实验室设备，添加国际先进检测设备，同时根据加热器实际使用工况建立 1:1 仿真腔体套装，进一步增加加热器的检测以及模拟能力，极大降低产品的不良率。

5、定制化工装开发技术

半导体设备金属零部件具有结构复杂、加工精度要求高、多品种、小批量的特点，加工制造过程对一致性和生产效率的要求极高。精密工装作为对零部件进行定位、夹持、锁紧的工具，其设计和使用会对产品的质量和生产效益产生较大影响。公司通过长期研发积累了门式工装、动力工装、标准化和互换性工装等技术并应用于生产实践，高效完成客户的定制化复杂产品需求，以此使得生产制造方式不断优化、现有设备及生产效率持续提升，同时与先进加工管理流程进行结合，实现了良好的成本与质量效益。

6、粉末烧结技术

报告期内，公司已形成从模拟分析到产品结构设计、粉末预处理、粉末压制成型、烧结致密化、精密加工等完整的粉末冶金生产工艺，可生产钨基高比重合金、氮化铝陶瓷及器件。在氮化铝加热器方面，具备从材料制备到成品制造的整套生产线，可实现在 500℃ 及以上高温下温度均匀的加热丝设计及多层氮化铝加热器制造工艺技术。

截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

2025 年度，公司研发投入金额 7,137.71 万元，占营业收入比重为 5.77%，较上年度增长 11.38%。

2025 年度，公司新增专利申请 39 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 30 项，获得专利 31 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 25 项；截至 2025 年末，公司共获得授权专利 129 项，其中发明专利 38 项、实用新型专利 91 项，全部应用于公司主营业务。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券 2024 年 11 月 29 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）50,595,000 股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 11.29 元/股，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣除保荐承销费用人民币 34,273,053.00 元（不含税），实际收到募集资金净额为人民币 536,944,497.00 元，于 2024 年 12 月 6 日由主承销商华泰联合证券存入公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行（账号：1115120129300800378）开立的募集资金专用账户中；另扣除其他相关发行费用人民币 24,720,154.08 元后，募集资金净额为人民币 512,224,342.92 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZA14483 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 280,596,945.82 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	571,217,550.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	58,993,207.08
二、募集资金净额	512,224,342.92
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	234,941,396.59
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	768,673.61
其他-购买现金管理产品的收益	2,545,325.88
三、报告期期末募集资金余额	280,596,945.82

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了相应的规定。

2、募集资金监管协议情况

根据前述监管机构的规定以及该管理制度，公司、公司全资子公司无锡先研新材料科技有限公司（以下简称“无锡先研”）已开立募集资金专户，并同保荐人及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31 日，协议具体情况如下表：

序号	签署日期	签署方	协议名称
1	2024 年 11 月 29 日	公司，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储三方监管协议
2	2024 年 11 月 29 日	公司，保荐人，中国农业银行股份有限公司靖江市支行	募集资金专户存储三方监管协议
3	2024 年 11 月 29 日	公司，保荐人，兴业银行股份有限公司泰州分行	募集资金专户存储三方监管协议
4	2024 年 11 月 29 日	公司，无锡先研，保荐人，招商银行股份有限公司泰州分行	募集资金专户存储四方监管协议
5	2024 年 11 月 29 日	公司，无锡先研，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储四方监管协议
6	2025 年 3 月 3 日	公司，保荐人，中国工商银行股份有限公司靖江支行	募集资金专户存储三方协议

以上协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

3、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800378	190,924.25	使用中
公司	兴业银行股份有限公司靖江支行	403020100100219459	34,032,152.63	使用中
公司	中国农业银行股份有限公司靖江城南支行	10220401040019030	70,148,976.26	使用中
公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300811337	972,613.82	使用中
无锡先研	招商银行股份有限公司靖江支行	523901886410008	59,867,090.53	使用中

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
无锡先研	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300800254	5,385,188.33	使用中
合计	-	-	170,596,945.82	-

注：截至 2025 年 12 月 31 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 110,000,000.00 元。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币 234,941,396.59 元。

2、募投项目先期投入及置换情况

在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目及已支付发行费用，截止 2025 年 1 月 15 日，自筹资金累计投入 78,713,554.46 元。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 73,573,966.42 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 5,139,588.04 元，置换金额共计人民币 78,713,554.46 元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）。报告期内，公司以募集资金完成了上述先期投入费用的置换。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，

在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截至报告期末，公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金共计 14,828,266.48 元，其中已以募集资金置换 13,459,817.83 元，其余 1,368,448.65 元尚未进行置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。截至 2025 年 12 月 26 日，前述募集资金理财资金已全部赎回归还至募集资金专户。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届审计委员会第二次会议，于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 300,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人发表了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 12 月

25 日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

2025 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募投项目“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，同意公司与保荐人及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

2025 年 3 月 3 日，公司在中国工商银行股份有限公司靖江支行开立了募集资金专户，并与保荐人及开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路 21 号-1）变更为靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江经济技术开发区新兴路 6 号、靖江经济开发区新太路 1 号、靖江经济开发区新兴路 9 号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路 9 号环普国际产业园 4 号库、5 号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。

（四）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

九、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员直接持有先锋精科股份及变动情况如下表：

单位：股

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
游利	董事长、总经理、核心技术人员	32,424,341	32,424,341	0	不适用
XU ZIMING	董事、副总经理、核心技术人员	8,121,706	8,121,706	0	不适用
XIE MEI	董事、董事会秘书	0	0	0	不适用
吴晓旭	董事（离任）	0	0	0	不适用

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
沈培刚	独立董事	0	0	0	不适用
杨翰	独立董事	0	0	0	不适用
于赞	独立董事	0	0	0	不适用
管明月	职工代表董事、首席运营官、核心技术人员	0	0	0	不适用
李镛	董事	1,000	1,000	0	不适用
陈彦娥	董事	0	0	0	不适用
杨丽华	首席财务官	0	0	0	不适用
刘国辉	首席技术官、核心技术人员	0	0	0	不适用
周红旗	工研部项目规划与管理总监、核心技术人员	0	0	0	不适用
贾坤良	工研部研发总监、核心技术人员	0	0	0	不适用
合计	/	40,547,047	40,547,047	0	/

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为游利先生，直接持有公司股份数量为 32,424,341 股，2025 年度，公司控股股东、实际控制人持股数未发生增减变动、质押或冻结。

2025 年度，董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有股份不存在质押、冻结及减持情况。

十、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

刘天宇
刘天宇

金鸣
金鸣

